

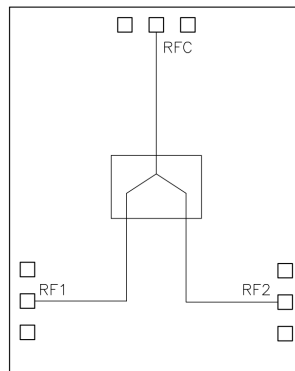
## 性能特点

- 频率范围：0.5~2GHz
- 振幅一致性：0.1dB典型值
- 输出回波损耗：21dB典型值
- 芯片尺寸：1.75\*1.4\*0.1mm

## 典型应用

- 卫星通信
- 仪器仪表
- 雷达
- 无线局域网

## 功能框图



## 概述

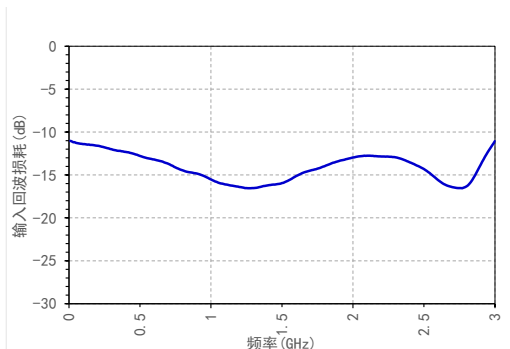
SIPS202 是一款0° 两路功分器芯片，其频率范围覆盖 0.5~2.0GHz，典型振幅一致性0.1dB，典型输出回波损耗21dB。

## 电性能表（T<sub>A</sub>=+25℃）

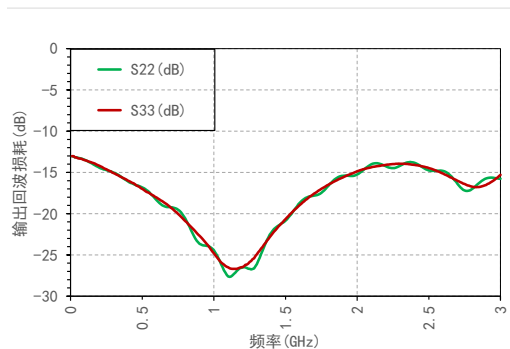
参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	0.5~2			GHz
插入损耗		4		dB
隔离		18		dB
振幅一致性		0.1		dB
相位一致性		0.7		deg
输入回波损耗(RFC端口)		14.8		dB
输出回波损耗(RF1/RF2端口)		21		dB

测试曲线

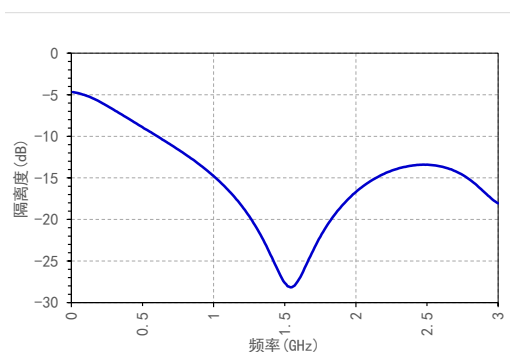
输入回波损耗VS频率



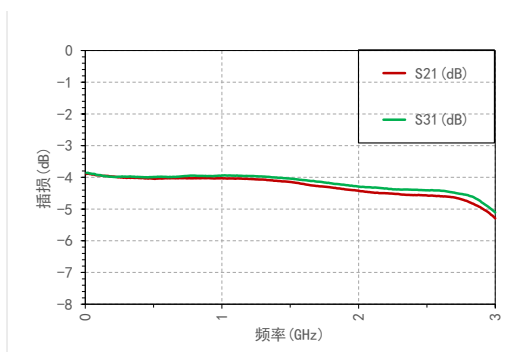
输出回波损耗VS频率 (@RF1 RF2)



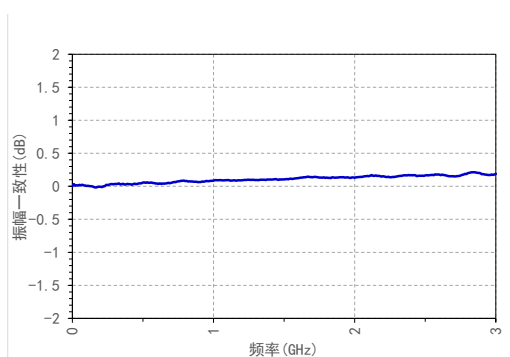
隔离度VS频率 (@RF1-RF2)



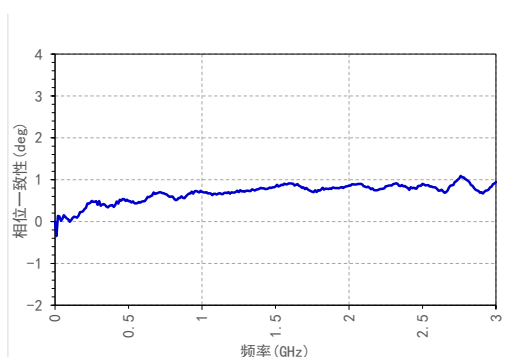
插损VS频率 (@RFC-RF1 RFC-RF2)



振幅一致性VS频率



相位一致性VS频率

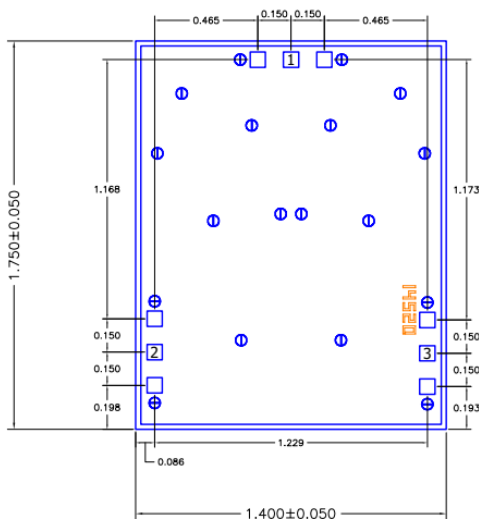


### 绝对最大额定值

工作温度	-55°C~+85°C
存储温度	-65°C~+150°C
功率输入	33dBm
ESD (HBM)	500V

### 芯片外形尺寸

#### 芯片外形尺寸

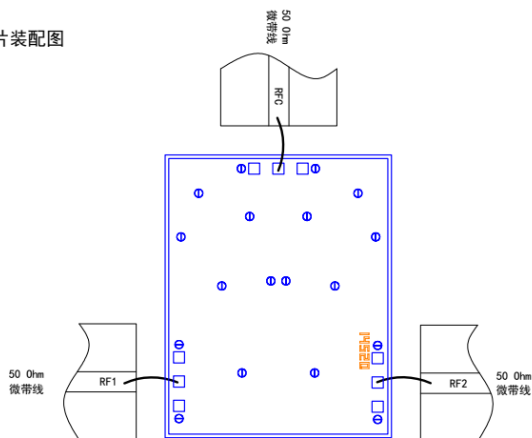


说明:

1. 单位: 毫米
2. 键合压点镀金, 压点尺寸:  
0.069\*0.069 (mm)
3. 芯片厚度: 0.100 ± 0.015mm
4. 不能在通孔上进行键合, 未编号键合  
压点也不需要键合
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地

### 芯片装配图

#### 芯片装配图



- 说明: 1. 芯片背面接地, 粘接材料: 导电胶  
2. 芯片键合线材料: 1mil Au  
3. 图中所有键合线长尽量短